



上海硅产业集团股份有限公司

National Silicon Industry Group Co., Ltd.

（上海市嘉定区兴邦路 755 号 3 幢）

关于上海硅产业集团股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

的审核中心意见落实函的回复

保荐人（主承销商）



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（上海市广东路 689 号）

上海证券交易所：

贵所于2019年10月31日出具的《关于上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》（上证科审（审核）〔2019〕680号）（以下简称“审核中心意见落实函”）已收悉。上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“硅产业集团”、“公司”、“发行人”）与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称“发行人律师”）和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关各方对审核中心意见落实函所列问题认真进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。

除另有说明外，本问询函回复中的简称或名词的释义与《上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿）》中的含义相同。

本问询函回复中**楷体加粗**内容为涉及在《招股说明书》补充披露或修改的内容，已在《招股说明书》中以**楷体加粗**方式列示。本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

目录

问题一.....	3
问题二.....	7
问题三.....	9

问题一

请发行人按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》的规定，突出重大性，增强针对性，并补充、完善以下事项：（1）结合公司产品技术与国际主要厂商的差距，市场竞争情况，进一步针对性的披露技术研发风险；（2）作为公司未来发展方向的300mm硅片产能利用率、产销量下滑；（3）目前公司生产经营主要依托报告期内收购的上海新昇、新傲科技、Okmetic三家子公司，直至2019年3月新傲科技才纳入合并报表范围，公司对上述子公司的业务重组及整合运营可能存在的风险；（4）Soitec股权市值变化对公司资产规模影响较大，未来如有出售对公司业绩影响较大；（5）公司境外销售收入占比较高，国际贸易环境变化、汇率变化等对公司生产经营的影响；（6）就股票期权激励计划对公司未来财务报表的影响做量化分析。

回复：

（一）结合公司产品技术与国际主要厂商的差距，市场竞争情况，进一步针对性的披露技术研发风险；

发行人已在招股说明书“重大事项提示”之“一、特别提醒投资者关注公司及本次发行的以下风险”之“（三）技术研发风险”及“第四节 风险因素”之“三、技术风险”之“（三）技术研发风险”部分补充披露如下：

“半导体硅片是芯片制造最重要的材料，是半导体产业的基石。同时半导体硅片也是我国半导体产业链与国际先进水平差距最大的环节之一。公司是我国率先实现300mm半导体硅片规模化生产的企业，300mm半导体硅片相关的技术达到了国内领先水平，但与国际前五大硅片制造企业在产品认证数量、适用的技术节点等方面相比仍有一定差距。当前公司正处于奋力追赶国际先进企业的进程之中。

半导体硅片行业属于技术密集型行业，具有研发投入高、研发周期长、研发风险大的特点。随着全球芯片制造技术的不断演进，对半导体硅片的技术指标要求也在不断提高，若公司不能继续保持充足的研发投入，或者在关键技术上未能持续创新，亦或新产品技术指标无法达到预期，将导致公司与国际先进企业的差距再次扩大，对公司的经营业绩造成不利影响。”

(二) 作为公司未来发展方向的 300mm 硅片产能利用率、产销量下滑；

发行人已在招股说明书“重大事项提示”之“一、特别提醒投资者关注公司及本次发行的以下风险”之“（十三）300mm 半导体硅片产能利用率、产销量下滑趋势延续的风险”及“第四节 风险因素”之“四、经营风险”之“（九）300mm 半导体硅片产能利用率、产销量下滑趋势延续的风险”部分补充披露如下：

“2019 年全球半导体行业景气度下降，公司 300mm 半导体硅片的销量增长不及预期，但产能仍处于稳定爬坡阶段，因此 2019 年 1-9 月公司 300mm 半导体硅片的产能利用率亦受到影响，下降至 44.36%。由于公司及时根据市场情况调整生产计划，公司 300mm 半导体硅片 2019 年 1-9 月的产销率仍保持在 94.05%。公司作为 300mm 半导体硅片领域的新进入者，在行业景气周期将分享行业红利，产能利用率和产销量较高，而在行业景气度低的周期，受到的影响也相应较大。公司受宏观经济和行业或自身因素影响，可能存在产能利用率、产销量短期内下滑趋势延续的风险。”

(三) 目前公司生产经营主要依托报告期内收购的上海新昇、新傲科技、Okmetic 三家子公司，直至 2019 年 3 月新傲科技才纳入合并报表范围，公司对上述子公司的业务重组及整合运营可能存在的风险；

发行人已在招股说明书“重大事项提示”之“一、特别提醒投资者关注公司及本次发行的以下风险”之“（八）子公司整合及管理风险”及“第四节 风险因素”之“五、管理和内控风险”之“（二）子公司整合及管理风险”部分补充披露如下：

“公司为控股型企业，公司报告期内通过业务重组控制了上海新昇、Okmetic、新傲科技三家子公司后，分别从资产、业务、团队建设等方面对上述子公司实施了整合，对控股子公司的研发、生产、经营、人事、财务等方面实施控制和管理。但是上海新昇报告期内尚未实现盈利，新傲科技纳入公司合并报表时间较短，而 Okmetic 位于境外，子公司管理难度较大。若公司对控股子公司的控制体系得不到有效的执行，公司可能无法及时了解相关子公司的实际经营情况，也无法实施有效的整合及管理措施，从而产生一定的子公司整合及管理风险。”

（四）**Soitec** 股权市值变化对公司资产规模影响较大，未来如有出售对公司业绩影响较大；

发行人已在招股说明书“第四节 风险因素”之“十一、**Soitec**二级市场股价波动风险”部分补充披露如下：

“截至2019年9月30日，公司持有**Soitec** 11.15%的股份。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，自2019年起，公司将持有的**Soitec**股票计入其他权益工具投资，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。资产负债表日公司所持**Soitec**股票公允价值变动部分计入公司其他综合收益；公司出售**Soitec**股票时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。虽不影响当期损益，但会影响公司的可分配利润。截至2019年9月30日，上述金融资产的账面价值为255,709.34万元，占资产总额的比重为28.29%。**Soitec**系法国巴黎证券交易所的上市公司，如果**Soitec**二级市场的股票价格发生大幅波动，虽不会影响公司当期损益，但会导致公司资产负债表日其他综合收益大幅波动，对公司的净资产形成较大影响。

”

（五）公司境外销售收入占比较高，国际贸易环境变化、汇率变化等对公司生产经营的影响；

发行人已在招股说明书“重大事项提示”之“一、特别提醒投资者关注公司及本次发行的以下风险”之“（十二）境外收入占比较高的风险”及“第四节 风险因素”之“四、经营风险”之“（四）境外收入占比较高的风险”部分补充披露如下：

“公司子公司**Okmetic**的生产基地位于欧洲，来自欧洲及北美客户的营业收入占比较高。报告期内，上海新昇300mm半导体生产线经历从建设、试生产到达产的各个阶段，营业收入持续增长但绝对金额较小，而新傲科技于2019年3月末前尚未纳入合并范围，报告期内**Okmetic**的营业收入在公司占比较高，同时上海新昇及新傲科技亦有部分营业收入来自于境外。2016年、2017年、2018年和2019年1-9月，公司的境外营业收入占比分别为90.91%、88.77%、80.88%及72.74%，虽然呈逐年下降趋势，但比重较大。如果出现国际贸易环境继续恶

化、关税壁垒继续增加、汇率出现大幅度波动等不利情形，将影响公司的境外收入，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

”

（六）就股票期权激励计划对公司未来财务报表的影响做量化分析。

发行人已在招股说明书“重大事项提示”之“一、特别提醒投资者关注公司及本次发行的以下风险”之“（十五）发行人股票期权激励计划**影响发行人盈利能力的风险**”及“第四节 风险因素”之“十、发行人股票期权激励计划**影响发行人盈利能力的风险**”部分补充披露如下：

“发行人2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案，该股票期权激励计划在发行人完成本次发行并在科创板上市后，将因股份支付会计准则，增加发行人未来的主营业务成本和期间费用。

基于截至2019年9月30日已授予且有效的期权份额，假设在未来年度都实现公司及个人的业绩考核要求、不考虑未来离职率影响的前提条件下，上述激励计划对发行人未来报告期间的成本、期间费用、利润总额和资本公积的具体影响如下：

单位：万元

科目	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合计
主营业务成本	167.14	250.72	186.34	103.63	26.12	733.96
期间费用	2,233.99	3,350.99	2,490.59	1,385.14	349.17	9,809.89
利润总额	-2,401.14	-3,601.71	-2,676.93	-1,488.78	-375.30	-10,543.85
资本公积	2,401.14	3,601.71	2,676.93	1,488.78	375.30	10,543.85

注：上述期权费用对未来报告期间的利润影响未考虑所得税的影响。

若发行人实施期权激励计划的效果不及预期，未来报告期间的营业收入及利润的增长无法覆盖期权激励计划造成的主营业务成本和期间费用的增加，则将对公司未来的盈利能力造成不利影响。

”

问题二

请发行人说明国盛集团、产业投资基金在公司上市后是否有取得公司控制权的计划，所持公司股份锁定期届满后是否有减持计划，如有，其对公司控制权状态的影响。

回复：

1、国盛集团、产业投资基金在公司上市后是否有取得公司控制权的计划，所持公司股份锁定期届满后是否有减持计划

根据国盛集团和产业投资基金出具的《关于股份锁定及减持事项的承诺函》和说明，国盛集团和产业投资基金关于所持硅产业集团股份的情况如下：

（1）国盛集团和产业投资基金均无在发行人上市后取得发行人控制权的计划，且自发行人股票上市之日起 12 个月内不主动谋求对发行人的控制权；

（2）国盛集团和产业投资基金在所持发行人股份 36 个月的锁定期届满后，减持计划如下：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在发行人实现盈利前，国盛集团和产业投资基金自发行人股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持其各自持有的首发前股份。自发行人股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的首发前股份均不超过发行人股份总数的 2%。

2、对公司控制权状态的影响

公司无控股股东和实际控制人。国盛集团和产业投资基金为公司并列第一大股东，持股比例均为 30.48%。

根据国盛集团和产业投资基金出具的说明，双方自发行人股票上市之日起 12 个月内不主动谋求控制权，有利于保证公司股权结构稳定、生产经营不因控制权发生变化而受到影响。

根据国盛集团和产业投资基金出具的股份锁定承诺，双方在发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

基于上述说明和承诺，公司无实际控制人的股权及控制结构、董事会构成

等公司治理结构在公司股票上市之日起 36 个月内发生实质性变化的可能性较小。

此外，国盛集团或产业投资基金不排除在发行人股票上市 12 个月后，通过二级市场增持、协议受让、认购发行人增发的股份等方式，提高持有发行人股票比例，从而导致发行人本次发行前并列第一大股东的持股比例发生变化，并可能导致公司董事会成员构成发生变化，公司治理结构的变化可能对公司经营和业绩的稳定性产生不利影响。为此，发行人在招股说明书“重大事项提示”之“（七）无实际控制人风险”中补充披露如下：

“（七）无实际控制人风险

公司无控股股东和实际控制人。截至本招股说明书签署日，国盛集团和产业投资基金为公司并列第一大股东，持股比例均为 30.48%。充分制衡的股权结构虽然有利于提高决策的科学性，但也可能影响公司的决策效率，在公司需要迅速做出重大经营和投资决策时，充分制衡的股权结构可能导致公司贻误发展机遇。

此外，国盛集团或产业投资基金虽然在自发行人股票上市之日起 12 个月内不主动谋求对发行人的控制权，且承诺自发行人股票上市之日起锁定 36 个月，但不排除在发行人股票上市 12 个月后，通过二级市场增持、协议受让、认购发行人增发的股份等方式，提高持有发行人股票比例，从而导致发行人本次发行前并列第一大股东的持股比例发生变化，并可能导致公司董事会成员构成发生变化，公司治理结构的变化可能对公司经营和业绩的稳定性产生不利影响。”

问题三

请发行人进一步说明招股书中“国家‘02 专项’项目责任单位”的具体含义，并结合相关行业标准与与境内外可比公司技术指标的对比情况，说明招股说明书中“行业领先”“国内领先”“国际领先”等表述的依据。如无，请删除。请保荐机构核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）国家“02 专项”责任单位的具体含义

“02 专项”项目由项目、课题和任务组成。项目一般为综合性的、集成性的，课题是为完成项目的目标分解设立的。同一项目分解出来的若干课题应在项目和课题间建立有机集成和衔接的机制，保证课题对项目的支撑，最终实现项目目标。项目责任单位是每个“02 专项”项目的牵头单位；部分项目存在下设子课题的情况，由不同的课题单位负责实施相应的子课题；如课题仍需进一步分解，则按照子任务的形式分配到各任务单位。

项目责任单位是“02 专项”项目的牵头单位，负责独立或全面统筹实施“02 专项”的具体研发工作。在项目实施过程中，项目责任单位除独立承担研发工作之外，还需统筹协调项目整体的研发及其他工作，汇总各课题执行情况，并向“02 专项”实施管理办公室汇报。

（二）结合相关行业标准与与境内外可比公司技术指标的对比情况，说明招股说明书中“行业领先”“国内领先”“国际领先”等表述的依据。如无，请删除。

半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料，半导体硅片需要尽可能地减少晶体缺陷，保持极高的平整度与表面洁净度，以保证集成电路或半导体器件的可靠性。

半导体硅片下游客户为各类芯片制造企业，面向存储器、逻辑芯片、模拟芯片、射频芯片、先进传感器等众多不同类型的芯片制造，不同客户、不同种类的芯片类型对于半导体硅片有着不同的规格要求。半导体硅片行业兼具技术密集型、资本密集型与人才密集型的特征，具有较高的技术门槛，半导体硅片企业能够实现规模化生产和销售本身即需要有一定的技术积累。半导体硅片技

术的发展，主要受下游芯片制造企业工艺制程技术发展的驱动。通常芯片制造企业会提出不同的硅片产品规格要求，半导体硅片企业根据这些产品规格要求来制定硅片企业内部的规格参数（同行业公司未公开披露）。因此，每一种硅片的技术参数都是定制化的，并无完全一致的规格参数，也无统一的行业标准。

1、关于公司 300mm 半导体硅片技术先进性的论述

半导体硅片尺寸越大，对半导体硅片的生产技术、设备、材料、工艺的要求越高。

（1）公司是中国大陆率先实现 300mm 半导体硅片规模化生产的企业

目前在全球半导体硅片行业中，国际前五大半导体硅片制造商常年占据 90%以上市场份额。与国际主要半导体硅片供应商相比，中国大陆半导体硅片企业技术较为薄弱，市场份额较小，多数企业以生产 200mm 及以下抛光片、外延片为主。

公司子公司上海新昇于 2014 年开始建设，2016 年 10 月成功拉出第一根 300mm 单晶硅锭，2017 年打通了 300mm 半导体硅片全工艺流程，2018 年最终实现了 300mm 半导体硅片的规模化生产，填补了中国大陆 300mm 半导体硅片产业化的空白。公司是中国大陆率先实现 300mm 半导体硅片规模化生产销售的企业。截至 2019 年 9 月 30 日，公司 300mm 半导体硅片产能达 15 万片/月，累计出货量 111.16 万片。

根据上海市集成电路行业协会的说明，上海新昇是中国大陆目前规模最大、率先实现 300mm 半导体硅片规模化生产与销售的企业，技术水平国内领先。

（2）产品通过全球领先的芯片制造企业客户认证

就半导体硅片行业而言，产品通过客户的认证情况，是对半导体硅片企业技术水平最为重要的衡量标准。截至 2019 年 9 月 30 日，公司 300mm 半导体硅片已通过认证的客户数量达 49 家，国内主要客户包括中芯国际、华力微电子、长江存储等多家企业，国际主要客户包括格罗方德、德州仪器、意法半导体等多家企业。

（3）公司的 300mm 半导体硅片可应用于先进制程芯片制造

制程即晶体管栅极宽度的尺寸，用来衡量半导体芯片制造的工艺水准。遵循摩尔定律，半导体芯片的制程已经从 $1\mu\text{m}$ 、 $0.35\mu\text{m}$ 、 $0.13\mu\text{m}$ 逐渐发展至当前的 90nm 、 65nm 、 40nm 、 28nm 、 16nm 、 10nm 、 7nm 。随着制程的不断缩小，芯片制造工艺对硅片缺陷密度与缺陷尺寸的容忍度不断降低。对应在半导体硅片的制造过程中，需要更加严格地控制硅片表面微粗糙度、硅单晶缺陷、金属杂质、晶体原生缺陷、表面颗粒尺寸和数量等技术指标，这些参数将直接影响半导体产品的成品率和性能。

90nm 及以下制程的芯片制造工艺主要使用 300mm 半导体硅片。目前，公司 300mm 半导体硅片产品可应用于 $40\text{-}28\text{nm}$ 、 65nm 、 90nm 制程，公司正在研发可用于 $20\text{-}14\text{nm}$ 制程的 300mm 半导体硅片。

（4）公司承担了 2 项 300mm 半导体硅片的重大科研项目

公司承担了 2 项与 300mm 半导体硅片相关的国家“02 专项”，分别是《 $40\text{-}28\text{nm}$ 集成电路用 300mm 硅片技术研发与产业化项目》与《 $20\text{-}14\text{nm}$ 集成电路用 300mm 硅片成套技开发与产业化项目》。

国家重大专项关系到我国科学技术、先进生产力的发展与国家竞争力的提升，公司承担 2 项 300mm 半导体硅片国家“02 专项”标志着公司在我国半导体硅片行业内研发实力、技术水平处于领先地位。

2、关于公司 200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）技术先进性的论述

（1）公司自主拥有的 200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）技术

①产品通过多家全球领先的芯片制造企业的认证

公司 200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）已通过多家国内外知名芯片制造企业的认证，包括台积电、中芯国际及华虹宏力等全球晶圆代工龙头企业，以及德州仪器、恩智浦等全球 IDM 龙头企业，和博世、Qorvo、Murata、Vishay 等全球模拟芯片和传感器龙头企业。

公司 200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）产品已具有一定的市场积累，与全球前五大半导体硅片企业一同成为多家全球芯片制造龙头企业的合格供应商，与全球前五大硅片企业的同规格产品相比，公司 200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）产品的技术指标同样已能满足相应客户的认证要求，技术水平领先。

②重大科研项目及技术创新奖

公司子公司新傲科技主要从事 200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）业务。新傲科技先后承担了 8 项重大科研项目，其中 5 项为国家“02 专项”。此外，新傲科技在技术创新方面曾荣获国家科学技术进步一等奖、上海市科学技术进步一等奖、中国科学院杰出科技成就奖等荣誉。新傲科技承担多项重大科研项目并取得了多项技术创新奖项，标志着新傲科技在半导体硅片行业内研发实力、技术水平领先。

③国际第三方产业组织执行委员会成员单位

国际半导体产业协会（SEMI）下设全球半导体硅片制造商联盟（SMG），联盟技术执行委员会成员单位共有 6 家企业，包括全球前 5 大半导体硅片企业信越化学、SUMCO、环球晶圆、Siltronic、SK Siltron 以及公司子公司 Okmetic。公司子公司 Okmetic 能够与国际龙头半导体硅片企业一同成为执行委员会成员，体现出其在半导体硅片技术方面得到了国际第三方产业组织的认可。

④公司是全球少数具有 SOI 硅片生产能力的企业

SOI 硅片作为特殊硅基材料，SOI 硅片生产工艺更复杂、成本更高、应用领域更专业，全球范围内仅有少数企业有能力生产。根据 SEMI 2019 年 8 月的报告，全球 SOI 硅片市场的主要供应商包括 Soitec、信越化学、公司子公司 Okmetic 及公司子公司新傲科技。

公司已掌握多种 200mm 及以下 SOI 硅片的生产技术，包括 SIMOX、Bonding 与 Simbond 技术，具有生产薄膜、中厚膜、厚膜等全部种类 SOI 硅片的能力。

根据上海市集成电路行业协会的说明，新傲科技是目前全球少数具有 SOI 硅片生产能力的企业，掌握 200mm 及以下 SOI 硅片的核心技术，达到国际先进水平。

（2）公司通过授权取得的 200mm 及以下 SOI 硅片技术

公司子公司新傲科技通过 Soitec 的授权取得全球领先的 SOI 硅片技术 Smart Cut™技术。

根据 SEMI 统计及 Soitec 公告文件，2018 年，全球 SOI 硅片销售额 7.17 亿

美元，Soitec 销售额 4.68 亿美元，Soitec 占全球 SOI 硅片销售比重高达 65.27%。Soitec 作为全球最大的 SOI 硅片企业，其最核心的技术 Smart Cut™ 是全球最领先的 SOI 硅片技术。

3、相关技术先进性表述的修改说明

鉴于，公司是中国大陆率先实现 300mm 半导体硅片规模化生产销售的企业，产品可应用于先进制程芯片制造，相关技术水平得到了多家全球领先的芯片制造企业的认证，是全球少数具有生产特殊硅基产品 SOI 硅片能力的企业，先后承担了多项重大科研项目，获得了包括国家科学技术进步一等奖在内的各级政府部门颁发的各类荣誉，亦担任国际第三方产业组织执行委员会的成员单位，并通过授权取得了全球领先的 SOI 硅片技术。因此，公司依据以上方面在招股说明书中描述公司半导体硅片技术处于国内领先、国际先进或国际领先水平，相关表述具有客观、独立的依据并符合时效性要求。

但是，由于半导体硅片行业并无完全一致的规格参数，同行业企业相关产品的具体技术指标目前并未披露，难以结合相关行业标准与与境内外可比公司技术指标，通过量化、直接对比等方式体现公司技术的先进性。因此，基于披露的谨慎性原则，公司招股说明书中关于 300mm 半导体硅片处于“国内领先”水平的表述不变，但将关于 200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）技术先进性的描述从“国际领先”、“国际先进”或“国内领先”统一修改为“国内领先”。

综上，公司已全面梳理招股说明书中关于技术先进性涉及“行业领先”、“国内领先”、“国际领先”的相关表述，公司主要产品涉及的关键技术的技术水平均达到国内领先水平。公司关于技术先进性的相关表述准确，依据充分。

二、核查过程及核查意见

（一）核查过程

保荐机构执行了如下核查程序：

- 1、查阅了发行人所处行业的公开研究报告、行业数据库等行业相关资料；
- 2、查询了信越化学、SUMCO、环球晶圆、Siltronic 及 SK Siltron 的官方网站、公告文件等通过公开途径可获取的产品技术有关资料；
- 3、检索了中国大陆主要半导体硅片企业的官方网站、公告文件，获取了其

在 300mm 半导体硅片、SOI 硅片方面的相关情况；

4、访谈了发行人高级管理人员与技术人员，了解了发行人在所处行业的技术水平、行业技术发展特点、技术衡量标准；

5、访谈了发行人下游主要客户，获取了发行人技术特点与产品优势相关资料；

6、获取了发行人所处行业协会出具的说明；

7、获取了全球半导体硅片制造商联盟（SMG）成员单位清单；

8、获取了公司承担重大科研项目的任务合同书，获得的技术创新奖的相关文件。

（二）核查意见

保荐机构认为：公司已全面梳理招股说明书中关于技术先进性涉及“行业领先”、“国内领先”、“国际领先”的相关表述，基于信息披露谨慎性的原则，公司招股说明书中关于 300mm 半导体硅片处于“国内领先”水平的表述不变，但将关于 200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）技术先进性的描述从“国际领先”、“国际先进”或“国内领先”统一修改为“国内领先”。公司关于技术先进性的相关表述准确，依据充分。

（此页无正文，为上海硅产业集团股份有限公司《关于上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函的回复》之盖章页）

上海硅产业集团股份有限公司



（此页无正文，为海通证券股份有限公司《关于上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函的回复》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

张博文

张博文

曹岳承

曹岳承



海通证券股份有限公司

2019年11月1日

声 明

本人已认真阅读上海硅产业集团股份有限公司本次审核中心意见落实函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽职原则履行核查程序，审核中心意见落实函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长签名：



周 杰

